

## JDB890-PU 聚氨酯灌封胶

### 产品描述

JDB890-PU 是一种双组份，可室温或加热固化的聚氨酯灌封胶。适合电子电器的封装密封。固化后具有高强度、高韧性，抵抗湿气和其它大气组分，无溶剂、无固化产物，在-40~125° C 间稳定的机械和电气性能。

### 产品特性

- 双组份，具有阻燃和导热性能；
- 固含量 100%，无有害气体挥发，无毒，环保；
- 具有较好的流动性，并能够很好的渗透电子元器件之间间隙；
- 抗振、防潮、防腐蚀，免受环境侵害；
- 优异的耐高低温性能、电气性能及绝缘性能；
- 在固化时放热量很低，无收缩，不开裂，可以形成坚固且富有弹性且导热性能优良的树脂层。

### 产品用途

适用于传统的需要灌封的浇注的电子元器件产品，例如电子电器、控制电源，LED 驱动电源等的整体封装。

### 技术参数：

项目	典型值		测试标准
<b>固化前物性 (25°C, 55%RH)</b>			
组分	A	B	--
外观	棕色液体	黑色流体	目测
粘度 (50°C) mPa·s	200±50	4500±2000	GB/T 2794-2013
比重 (25°C) g/cm <sup>3</sup>	1.10±0.05	1.50±0.10	GB/T 533-2008
重量混合比(A:B)	1: 5		--
混合粘度 (50°C) Pa·s	1500±1000		GB/T 2794-2013
可操作时间 (100g, 25°C) min	30~50		GB/T 7123.1-2015
完全固化时间 (100g, 25°C) h	24~48		GB/T 7123.1-2015
完全固化时间 (100g, 60°C) h	1~2		GB/T 7123.1-2015
<b>固化后特性 (25°C, 55%RH)</b>			
外观	黑色弹性体		目测
硬度 Shore A	75±10		GB/T 531.1-2008
膨胀系数 μm/(m, °C)	≤120		GB/T 20673-2006

拉伸强度 Mpa	1.0~2.0	GB/T528-2009
导热系数 W/m.K	0.6±0.2	GB/T10297-1998
体积电阻 $\Omega \cdot \text{cm}$	$3.0 \times 10^{14}$	GB/T1410—2006
介电强度 kV/mm	$\geq 27$	GB/T1408.1—2006
介电损耗 (50Hz)	$\leq 0.02$	GB/T 1409—2006
吸水率 (24h, 25℃) %	$< 0.2$	GB/T 8810-2005
阻燃性能	V0	UL94
可用温度范围 (℃)	-40~125	--

\*注：表格中数据为某特定条件下实测数据，仅供参考；粘度、颜色、固化时间可以根据使用者要求进行调整。

## 使用说明

- 贮存过程中可能会产生些许沉降，请在使用前将 B 组份在贮存容器中搅拌均匀，再按 A:B=1:5 的质量比例进行配比，当混合时，必须注意不要导入过多的空气，建议使用自动混合设备不仅可以按正确比例精准混合树脂和固化剂，而且不会导入空气。
- 混合 A/B 组份必须在干净的容器中进行，加入指定质量比例 A/B 组份后完全混合均匀，用力搅拌混合容器的边缘及底部，以确保混合均匀。
- 为了降低混合物的粘度以便于后续灌封，可在混合前将 B 组份加热到 50℃。若在 5-10mbar 的真空中度下将混合物脱泡后再进行灌封使用，可以达到更加优良的力学及电性能；
- 烘烤温度：60±5℃ 下烘烤。
- 烘烤时间：1 小时以上。

## 注意事项

- 远离儿童存放。
- 建议在通风良好的场所内使用。
- 使用时避免直接接触，应使用手套等保护设备，若不慎粘到皮肤上，须马上用肥皂水清洗。若不慎粘到眼睛上，须先用大量的水清洗并到医院检查。
- 仅限工业用途，详情请参考MSDS。

## 包装规格

30KG/套 (A 组分: 5Kg/ 桶; B 组分: 25Kg/ 桶)。

## 储存及运输

- 存放于干燥、阴凉处，避免太阳直晒，温度在 35℃ 以下，相对湿度在 80% 以下。
- 在 0-35℃ 未开封保存时，产品自生产之日起保质期为 6 个月。
- 本产品为非危险品，按一般化学品贮存、运输。